

博敏电子股份有限公司

关于子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 博敏电子股份有限公司(以下简称“博敏电子”或“公司”)
- 是否为上市公司关联人: 否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额分别为人民币 18,000 万元、150,000 万元。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

公司因日常经营发展需要,向交通银行股份有限公司梅州分行(以下简称“交通银行”)申请授信额度为人民币 18,750 万元,期限自 2022 年 8 月 1 日至 2024 年 4 月 13 日止,同时公司以部分自有设备和厂房作为抵押,并由深圳博敏、江苏博敏共同为上述授信提供连带责任保证担保,担保金额为 18,000 万元。

公司因日常经营发展需要,向中国建设银行股份有限公司梅州市分行(牵头行、代理行,以下简称“建设银行”)、中国银行股份有限公司梅州分行(以下简称“中国银行”)、中国农业银行股份有限公司梅州分行(以下简称“农业银行”)和交通银行组成的银团申请授信额度为人民币 150,000 万元,期限为十年,同时公司以部分固定资产作为抵押,并由深圳博敏、江苏博敏共同为上述授信提供连带责任保证担保,担保金额为 150,000 万元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关

规定，深圳博敏、江苏博敏已就上述担保履行了内部决策程序，上述担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：博敏电子股份有限公司

统一社会信用代码：914414007730567940

注册及主要办公地点：梅州市经济开发试验区东升工业园

成立日期：2005 年 3 月 25 日

注册资本：51,101.21 万元人民币

法定代表人：徐缓

经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI 印刷电路板等新型电子元器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；投资；不动产及机器设备租赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，博敏电子资产总额为 655,168.31 万元，负债总额为 292,001.95 万元，其中银行贷款总额为 106,294.48 万元、流动负债总额为 245,592.20 万元，归属于上市公司股东的净资产为 361,555.96 万元，2021 年营业收入为 352,066.02 万元，归属于上市公司股东的净利润为 24,187.19 万元。（以上数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，博敏电子资产总额为 658,491.51 万元，负债总额为 291,338.64 万元，其中银行贷款总额为 127,963.13 万元、流动负债总额为 223,137.26 万元，归属于上市公司股东的净资产为 365,511.90 万元，2022 年一季度营业收入为 66,089.42 万元，归属于上市公司股东的净利润为 4,058.62 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议主要内容

（一）交通银行担保合同

担保金额：人民币 18,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

（二）银团担保合同

担保金额：人民币 150,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。借款人与银团达成期限变更协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自期限变更协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致银团宣布主合同提前到期的，保证期间自银团确定的债务提前到期之日起三年。

保证范围：根据主合同的约定，借款人向银团借款人民币 150,000 万元，借款期限 10 年，其中：（1）中国建设银行股份有限公司梅州市分行：75,000 万元；（2）中国银行股份有限公司梅州分行：35,000 万元；（3）中国农业银行股份有限公司梅州分行：28,000 万元；（4）交通银行股份有限公司梅州分行：12,000 万元。

保证人愿意就主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有

关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）向银团提供担保。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是由全资子公司深圳博敏、江苏博敏提供，为满足公司在经营过程中的资金需要，被担保方为公司，公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 189,749.49 万元（均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产 52.48%；公司对控股子公司提供的担保总额为 189,749.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.48%（不含本次担保）。目前公司及子公司对外担保的在保余额为 67,885.02 万元（不含本次担保）。

备注：担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日